

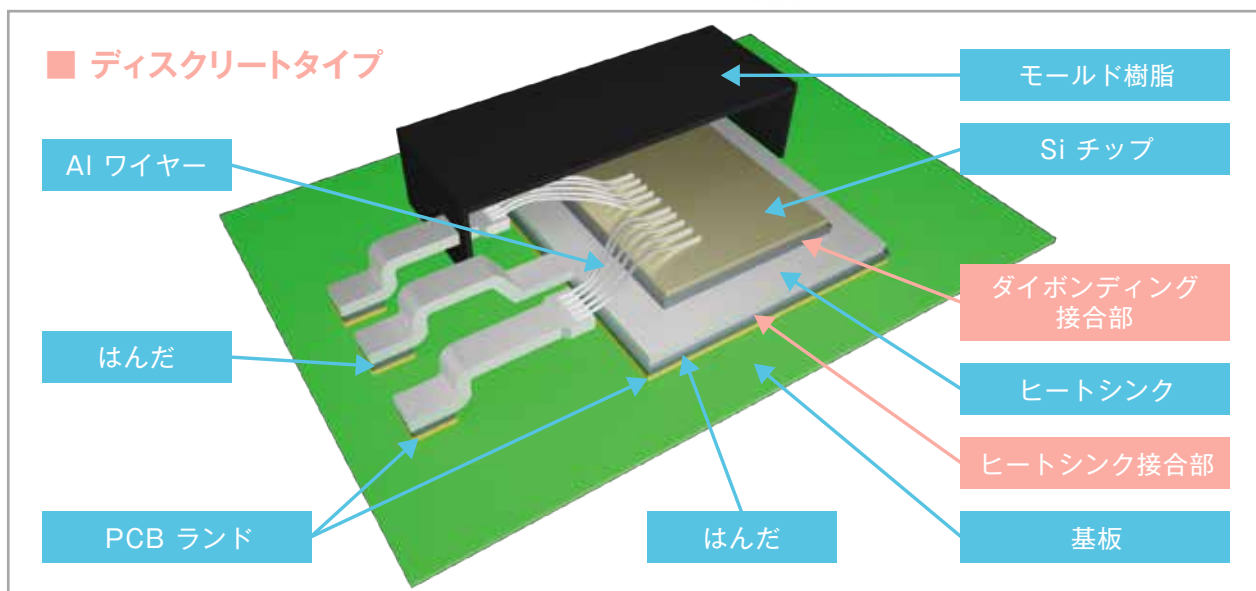
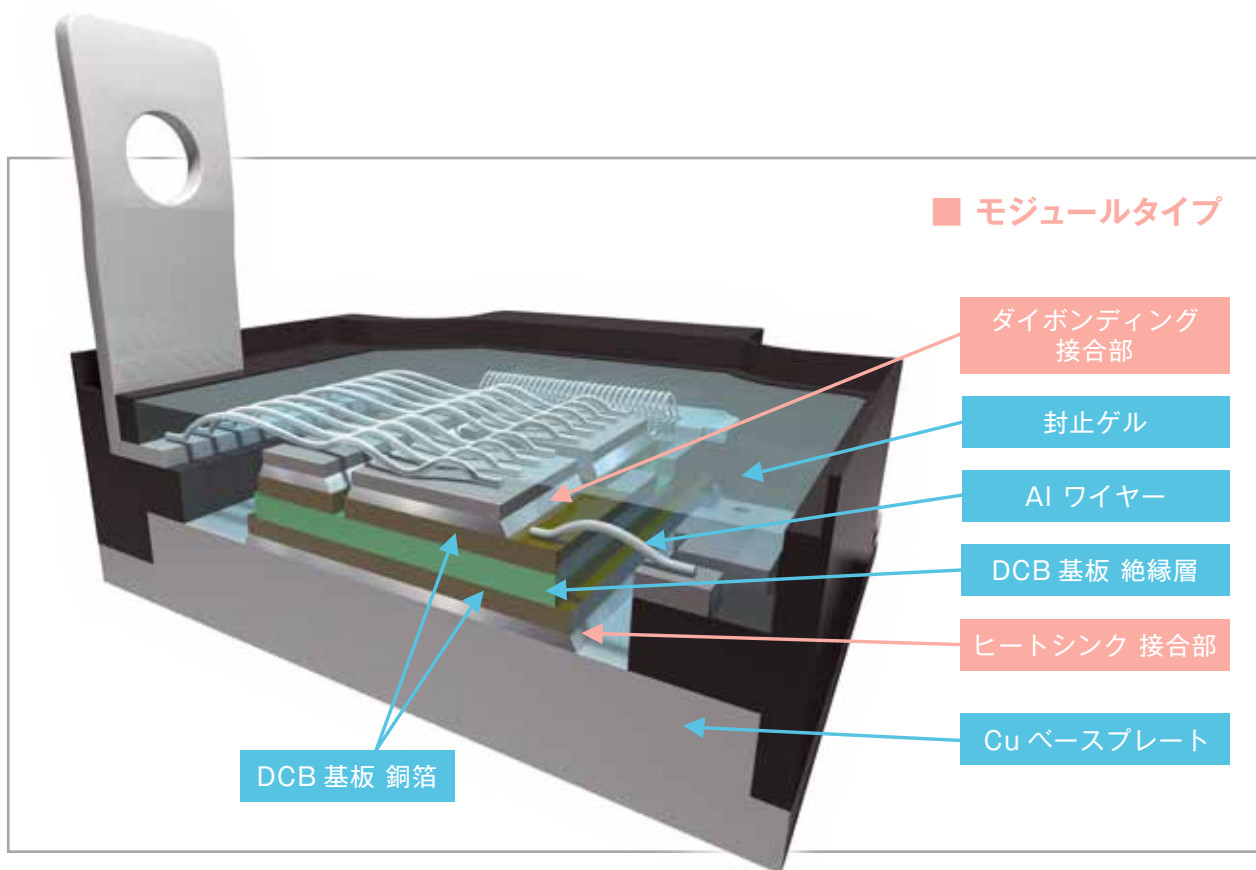
E14シリーズ

開発品

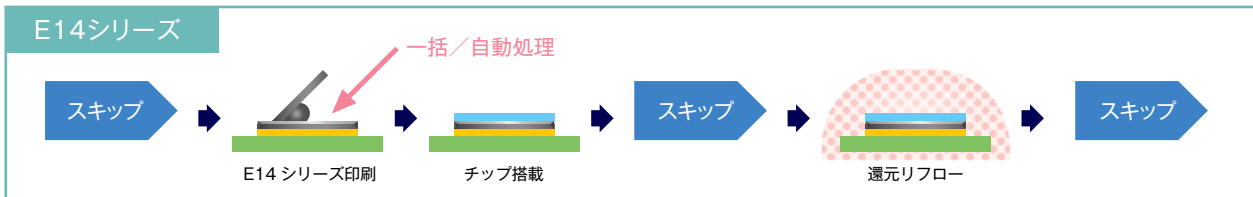
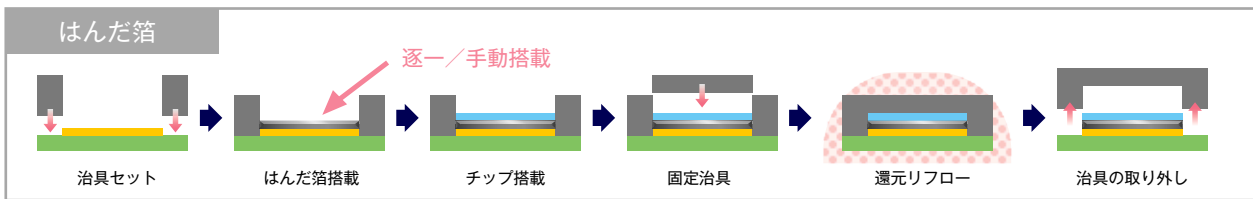


ギ酸還元真空リフロー用ソルダーペースト

- IGBT やパワー MOSFET 等のパワーデバイス接合用ソルダーペーストです。
- はんだ箔接合を代替する超低ボイド接合を実現、トータルコストダウンが図れます。
- 還元雰囲気リフロー（ギ酸）にて、良好な接合が得られます。
- ソルダーペーストは印刷、もしくはディスペンス塗布で供給できます。



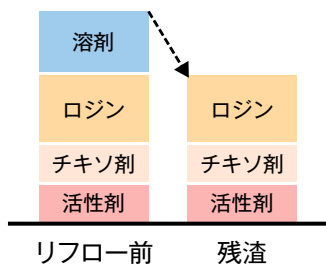
■ ソルダーペーストのメリット



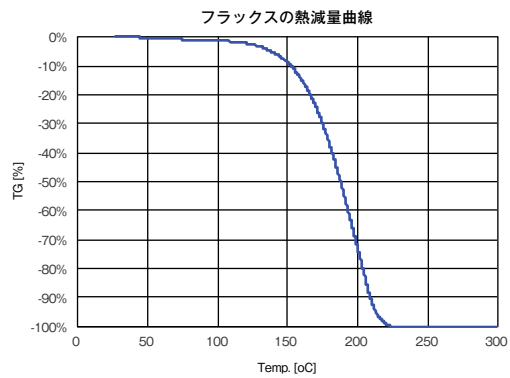
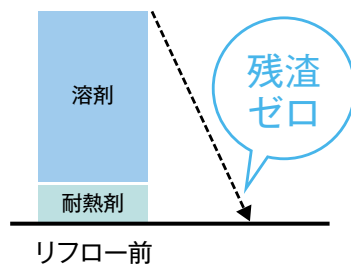
E14シリーズのフラックス設計

E14シリーズは、はんだ付け温度である230℃以上の温度をかけることで、すべての成分が完全減量する設計として開発されました。

ロジン系ソルダーペースト



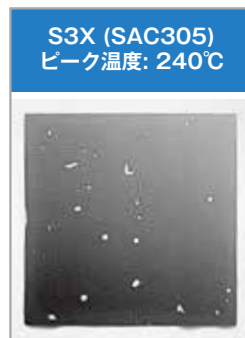
E14シリーズ



ボイド特性

評価方法

- 基板 : 無酸素銅板
- 部品 : Siチップ (Au/Niスパッタ膜) 10×10mm
- メタルマスク厚 : 200μm (レーザー)



1.24%



1.36%



1.29%

タックフラックス 開発品

製品名	S3X48-E14	*S3X48-E14D	TS48-E14	*TS48-E14D	S5A48-E14	*S5A48-E14D
合金組成 (%)	Sn 3.0Ag 0.5Cu		Sn 3.5Ag		Sn 5Sb	
融点 (°C)	217 - 219		221		238 - 241	
ハライド含有量 (%)	0					
フラックスタイプ	ORLO					

製品名	TF-E12
ハライド含有量 (%)	0
フラックスタイプ	ORLO
タック時間 (hour)	24
色	白

* ディスペンス用

* 物性変更の可能性があります。

